

COB全倒装集成封装,表面采用新型膜+热压工艺,防水防潮防尘防磕碰,核心混BIN算法,LED色彩一致性高

产品名称	COB全倒装集成封装,表面采用新型膜+热压工艺,防水防潮防尘防磕碰,核心混BIN算法,LED色彩一致性高
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1.RGB全倒装集成封装;
- 2、表面采用新型膜+热压工艺,防水防潮防尘防磕碰;
- 3、表面覆膜,对LED发光形成折射,显示柔和;
- 4、核心混BIN算法,LED色彩一致性高;
- 5、像素结构:1R1G1B;
- 6、封装方式:COB全倒装;
- 7、像素间距:1.25mm;
- 8、像素密度:640000点/m²;
- 9、箱体模组组成:2×4;
- 10、箱体尺寸:600(W)mm×337.5(H)mm×35(D)mm;
- 11、箱体分辨率:480×270;
- 12、箱体面积:0.2025m²;

- 13、箱体重量：4.5 kg；
- 14、箱体材质：压铸铝箱体；
- 15、维护方式：完全前维护；
- 16、模组尺寸：150*168.75mm；
- 17、模组分辨率：120*135；
- 18、白平衡亮度：0-1200 cd/m²可调；
- 19、色温：3000-10000 K可调；
- 20、可视角：160° (H)/160° (V)；
- 21、对比度：18000：1；
- 22、色度均匀性：± 0.003Cx, Cy之内；
- 23、亮度均匀性：97%；
- 24、驱动方式：恒流驱动；
- 25、换帧频率：60 Hz；
- 26、刷新率：3840 Hz；
- 27、灰度等级：16 bit；
- 28、峰值功耗：320 W/m² (600 nits)；
- 29、平均功耗：106 W/m² (600 nits)；
- 30、供电要求：110~220 VAC ± 15%；
- 31、工作温度：-10 ~ 40 ；
- 32、工作湿度：10%~90% RH (无冷凝水)；
- 33、存储温度：-20 ~ 60 ；
- 34、存储湿度：10%~90% RH (无冷凝水)；
- 35、发光芯片波长范围 < 2.5nm，分光比1.2；具备取晶-固晶算法，单板无色差；具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差；
- 36、通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸 < 75 μm的滑石粉，尘降量600g/ (m² · d)，自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；。

37、通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；

38、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130 ；